

Hot Issue

〈SoC Fair 2008〉 구석구석을 살펴본다.

국내 유일 SoC/IP 전문 전시회인 SoC Fair가 지난 14일 8회째 개최되었다. 쉽지 않은 대내외 환경 속에서도 꾸준한 발전을 이루고 있는 국내 SoC기업들이 올린 알찬 성과를 돌아보고 국내외 기술 및 산업 전망을 통해 보다 큰 내년을 준비하는 자리였다. 특히 올해는 컨퍼런스, LG day, 해외 바이어 초청 비즈니스상담회, 기술이전 Fair, Job Fair 등 다양한 부대 행사를 마련해 SoC Fair 2008이 참가기업 모두에게 실질적인 비즈니스의 장이 될 수 있도록 기획했다.

국내 유일의 SoC/IP 전문전시회 〈SoC Fair 2008〉

지식경제부가 주최하고 한국반도체산업협회, 정보통신연구진흥원, 한국전자통신연구원 등이 주관하는 'SoC Fair 2008'이 10월 14일~17일 나흘간 일산 KINTEX에서 열렸다. 이 행사는 Fabless 반도체업체들이 중심이 되는 국내 유일의 SoC(System on Chip)/IP(Intellectual Property)전문 전시회다.

'SoC Fair 2008'에서는 전시회뿐만 아니라 컨퍼런스, LG day, 해외 바이어 초청 비즈니스상담회, 기술이전 Fair, Job Fair 등 기술, 인력, 마케팅 등의 영역에서 시스템반도체 산업을 활성화 시키기 위한 종합적인 비즈니스 장터가 열렸다. 특히 IT 글로벌 리더인 LG전자가 별도 상담 공간을 마련하고 국내외 주요 SoC업체들과 협력을 모색하였고 중흥통신, 소니 등 다양한 해외 전자업체들도 구매 상담에 적극 참여하여 본 행사를 더욱 빛냈다.

〈SoC Fair 2008〉에서는 어떤 행사가 펼쳐졌나?

이번 행사에는 코아로직, 엠텍비전, 티엘아이, 벡서스칩스 등 국내 시스템반도체업체를 이끌어가는 주요 업체가 참가하여 최신 기술과 신제품을 선보였다. 또한 한국전자통신연구원, 전자부품연구원, 한국과학기술원 등 연구소, 학교에서도 참여하여 우수한 연구결과물들을 전시하였다.

최고 권위의 SoC 및 융합부품 전문 컨퍼런스인 시스템반도체 컨퍼런스는 전시회 못지 않게 업계 관계자들로부터 많은 관심을 받았다.

올해에는 방송통신, 가전, 자동차, 의료, 조선, 건설, 국방, 산업 전망 등을 주제로 모두 9개 세션에서 심도 있는 주제 발표와 활발한 토론이 이뤄졌다.



현대자동차의 양웅철부사장이 “차량용반도체 기술동향”, 쉐일컴의 김제우 부사장이 “Toward 4G Wireless Technologies”란 제목으로 기조연설을 하였다. 이외에 삼성전자, LG전자뿐만 아니라 현대자동차, 현대중공업 등 기간 산업 대기업 및 시스템반도체 기업 임원급 연사들이 참여하여 강연을 통해 업계의 고급정보를 나누었다.

또한, 한국전자통신연구원, 전자부품연구원, 국방과학연구소, 서울대, 고려대 등 연구소 및 학계 전문가들이 참여하여 시스템 및 반도체 기술의 발전방향에 대해 심도 있는 강연을 하였다.

세션은 총 9개로 구성되었으며, 지금까지 SoC 산업 발전 동향

점검은 물론 향후 기술 발전 방향에 대해 각계 최고의 전문가 38명의 명강의가 있었다.

올해 처음 열린 기술이전 Fair는 한국전자통신연구원, 전자부품연구원, 한국과학기술원 등 연구소와 대학에서 개발한 핵심기술들을 산업체가 이전 받아 기술경쟁력을 강화할 수 있는 장을 마련했다.

Job Fair는 전자공학분야 석·박사 학생들과 팹리스 기업들이 채용면담을 갖도록 주선하였다. 별도로 조성한 면접부스에서 한국전자통신연구원이 설계교육을 통해 집중적으로 양성한 우수한 엔지니어들이 팹리스기업들과 채용면담을 가질 수 있도록 하였다.

작년에 이어 올해로 2회를 맞은 LG day가 10월 16일, 17일 양일간 개최되었다. 국내 대표 IT산업 리더인 LG전자의 모바일커뮤니케이션사업본부가 참여하여 우수 시스템반도체기업과 1:1비즈니스미팅을 갖고 상호 협력방안을 모색하였다.

올해 5회째 열린 해외바이어 초청 비즈니스상담회에도 많은 해외업체들이 참여하여 국내업체들과 비즈니스 상담을 하였다. 중국 중흥통신, 일본 샤프 등 해외 주요 시스템업체 15개사가 참여하여 국내 팹리스기업들과 수출상담을 진행하였다.

한편 전시 기간 중 다채로운 이벤트와 경품 행사로 참관객들에게 또 다른 즐거움을 선사한다.



● 행사개요

- 행사명 : SoC Fair 2008
- 장소 : 일산 KINTEX
- 일시 : 2008년 10월 14일(화)~17일(금), 4일간
- 주최 : 지식경제부
- 주관 : 한국반도체산업협회, 한국전자통신연구원, 정보통신연구진흥원

● 전시 품목

- SoC(System on Chip)
- IP(Intellectual Property)
- System in Package Solution
- Embedded System HW&SW
- SoC Design Tool(EDA)
- Package & Test Service
- 센서 및 융합제품

● 부대 행사

- 시스템반도체 컨퍼런스 2008
- LG day
- 해외 바이어 초청 비즈니스 상담회
- 기술이전 Fair
- Job Fair



전시회 참여 기업 소개

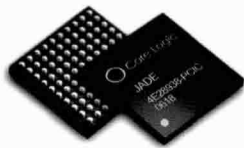
코아로직



회사 소개

1998년 설립된 코아로직(대표 황기수 www.corelogic.co.kr)은 국내 대표 팹리스 기업으로서, 디지털 산업의 핵심인 SoC 기술 개발을 통해 첨단 멀티미디어 솔루션을 제공한다. 우수한 기술력을 바탕으로 휴대폰을 비롯한 다양한 모바일 디지털 디바이스의 멀티미디어 솔루션을 제공하고 있으며, 휴대폰 솔루션은 카메라폰의 핵심 부품인 카메라 어플리케이션 프로세서(CAP: Camera Application Processor) 제품군과 첨단 멀티미디어폰의 핵심 부품인 멀티미디어 어플리케이션 프로세서인 MAP(Multimedia Application Processor) 제품군, 메가픽셀급 이상의 카메라폰에서 고급 디지털 카메라 기능을 제공하는 이미지 시그널 프로세서인 ISP(Imaging Signal Processor) 제품군을 갖추고 있다. 휴대폰 솔루션의 시장성과 기술력을 인정받으며 빠른 성장을 거듭해온 코아로직은 PMP, 내비게이션, 디지털 포토 프레임 등 다양한 모바일 디지털 디바이스 시장을 개척하여 비즈니스 역량을 확대하고 있다. 2007년 보광 그룹의 계열사로 편입한 이후, 제품 개발 및 혁신적인 경영을 발판으로 디지털 세상의 멀티미디어 구현(Enabling multimedia to every digital existence)의 꿈을 실현해 가고 있다.

전시제품 소개



코아로직 제이드는(JADE)는 2007년 출시되어 올해의 베스트 제품으로 평가 받고 있다. 최대 500만 화소 이상의 해상도를 지원하는 JPEG 코덱과 D1급 동영상을 초당 30 프레임까지 녹화 및 재생 가능하며, 동영상 촬영은 QVGA급으로 초당 120 프레임의 초고속 촬영이 가능하다. 범용 비디오 포맷인 MPEG4 및 압축률이 높은 H.264 비디오 포맷을 지원하며, 아울러 MP3는 물론 WMA, RA, AAC+, BSAC 등 다양한 오디오 포맷을 지원하고, 화상통화, TV 출력 등의 기능도 포함하고 있다. 또한 이 제품은 최신버전 DRM과 USB2.0, 미디어 트랜스퍼 프로토콜(MTP: Media Transfer Protocol)에 의해 원활한 콘텐츠 공유가 가능하며 저전력 소모 설계로, UCC 기능을 포함한 프리미엄급 캠코더폰 솔루션에도 적합하다.

코아로직 제이드는(JADE)는 2007년 출시되어 올해의 베스트 제품으로 평가 받고 있다. 최대 500만 화소 이상의 해상도를 지원하는 JPEG 코덱과 D1급 동영상을 초당 30 프레임까지 녹화 및 재생 가능하며, 동영상 촬영은 QVGA급으로 초당 120 프레임의 초고속 촬영이 가능하다. 범용 비디오 포맷인 MPEG4 및 압축률이 높은 H.264 비디오 포맷을 지원하며, 아울러 MP3는 물론 WMA, RA, AAC+, BSAC 등 다양한 오디오 포맷을 지원하고, 화상통화, TV 출력 등의 기능도 포함하고 있다. 또한 이 제품은 최신버전 DRM과 USB2.0, 미디어 트랜스퍼 프로토콜(MTP: Media Transfer Protocol)에 의해 원활한 콘텐츠 공유가 가능하며 저전력 소모 설계로, UCC 기능을 포함한 프리미엄급 캠코더폰 솔루션에도 적합하다.

엠텍비전



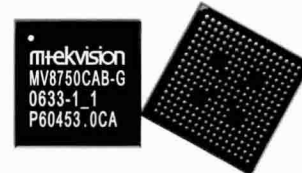
회사 소개

1999년에 설립된 엠텍비전(대표 이성민 www.mtekvision.co.kr)은 세계적인 모바일 이미징 & 멀티미디어 반도체 설계 기업이다. 국내 최초로 카메라폰 핵심부품인 카메라 컨트롤 프로세서(CCP)를 독자 기술로 개발해 2004년 국내시장 1위를 달성, 팹리스기업이라는 새로운 산업군을 형성하며 글로벌 기업으로 성장했다.

엠텍비전은 휴대폰, 스마트폰, PDA, MP3 플레이어 등의 모바일 기기에 혁신적인 솔루션을 제공해 왔으며, 현재까지 전세계 1,000여 개의 모바일 기기에 2억개 이상의 모바일 멀티미디어IC를 공급하였다.

전시제품 소개

테마	세부구분	데모 컨셉 설명	제품명
Multimedia (멀티미디어)	OpenOS with Multimedia	• WinCE 기반 멀티미디어 구동 시연 • AMOLED 패널 장착	MV8760
	Mobile TV	• 모바일TV 데모시연 • DVB-H (유럽규격) 데모 • CMMB (중국규격) 데모	MV8729 MV8722
	Multimedia Credit Card('KB&dCard')	• 세계최초 멀티미디어 신용 카드	MV8722
	TV out	• D1급 동영상 대형PDP로 재생 시연	MV8729
	Sensor	• 전장용 광역보정기능(WDR) 이미지 센서 • 비접촉식 동작 인식 시스템	MV5103 MV5011
Imaging (이미징)	CSP (Camera Signal Processor)	• 디지털카메라 수준의 화질을 구현하는 고효소 이미지처리 칩 • 실시간 얼굴인식 데모 시연 • AL(자동조도조정), DIS(손떨림보정) 샘플영상 시연	MV9337
	Communication(통신)	Baseband	• GSM/GPRS방식 이동통신 모뎀 SoC • 통신 시연



전시회 참여 기업 소개

티엘아이



회사 소개

티엘아이(대표 김달수 www.tli.co.kr)는 LG 반도체 연구원 출신인 김달수 대표이사를 중심으로 실력있는 연구원들이 모여 1998년에 설립된 팹리스(Fabless)기업이다. 올해로 설립 11년째를 맞는 티엘아이는 73%의 비중을 차지하는 연구인력을 기반으로 자체 개발한 아날로그 설계자산(IP)을 보유하고 있으며, 이를 통해 압도적인 제품개발 속도와 원가경쟁력을 주력 제품인 Timing Controller 국내 1위를 달리고 있다. 그 결과 2007년 매출액 520억원에서 2008년에는 상반기 매출액만 403억원을 달성하는 등 지속적인 성장가도에 있다.

회사의 핵심 기술은 자체 개발을 통해 구축한 다양한 아날로그 기술이라 할 수 있다. 고부가가치 제품 개발을 위한 아날로그 회로 설계 연구로 우수한 성능의 아날로그 설계자산을 개발하였고, 이 기술들을 밑바탕으로 한 다양한 제품들을 개발, 기술을 선도하고 있다.

특히 2007년 120Hz Full HDTV용 Timing Controller를 업계 최초로 개발하여 주요거래처인 LG디스플레이 납품하고 있으며 고품질 TV용 Timing Controller는 타의 추종을 불허하는 위치에 있다. 또한 티콘과 함께 LCD TV의 핵심 구동 IC인 LCD Driver IC를 중국 BOE-OT사에 납품하기 시작하면서 해외시장 공략에도 박차를 가하고 있고, 내년부터 중화권 시장의 신규매출처를 추가로 확보할 예정이다.

전시제품 소개

타이밍 컨트롤러는 TFT-LCD 모듈에 입력된 영상정보를 처리하여 드라이버 집적회로(Driver IC: 액정 패널을 구동 또는 제어하기 위한 필수적인 집적회로)에 신호를 전달해주는 기능을 수행한다.

디지털 신호를 패널에 알맞게 아날로그 신호로 전환하여 각 픽셀에 정보를 제공하는 드라이버 집적회로에서 게이트·소스에 전달해주는 신호의 동기화가 중요하다. 신호처리의 정확성과 신속성이 LCD의 성능을 결정짓고 이러한 중요한 역할을 타이밍 컨트롤러가 맡고 있다. 또한 라인의 변화와 프레임의 변화 등 영상의 변화를 패널에 인식시키기 위한 신호를 타이밍 컨트롤러에서 만들어준다.

아이앤씨테크놀로지



회사 소개

아이앤씨테크놀로지(대표 박창일 www.inctech.co.kr)는 모바일 TV용 칩, 셋톱박스 전용 칩, DSRC를 개발하는 반도체 설계 전문기업이다.

1996년 설립 초기에 주문형반도체(ASIC) 설계를 주력사업으로 시작해 DMB 및 DAB, 디지털오디오앰프 등의 전용 칩 개발에 지속적으로 투자, 현재는 자체 브랜드를 가진 반도체 칩 개발 전문기업으로 성장했다.

2004년 업계 최초로 지상파 DMB용 핵심 반도체인 RF칩을, 2005년 베이스밴드칩을 개발하여 국내 최초로 RF칩과 베이스밴드칩을 동시에 보유하게 되었다.

국내 최초 T-DMB RF IC, RFT200의 양산을 시작으로 RFT400, RFT500과 세계 최소형 RF+BB SoC ONE CHIP 제품, T3300을 개발하여 핵심부품의 국산화를 이루어내었으며, ISDB-T, DVB T/H, CMMB, DMB TH 등 해외 Mobile TV의 표준에 적합한 IC를 개발하여 작지만 강한 Global 회사로서 자리잡아 가고 있다.

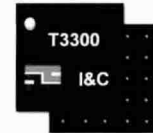
현재 국내 유수의 DMB 휴대폰과 DMB 네비게이션, PMP, 디지털카메라 등에 아이앤씨테크놀로지의 제품이 채용되고 있다.

전시제품 소개

T-DMB Solution으로는 StarRFT500, T3300(Mobile), T3500(Mobility)을 ATSC M/H, CMMB로는 RFG7400, RFG7700 등의 제품이 전시되었으며, 소모 전력량을 크게 낮춘 DMB 통합수신칩(RFT500)과 크기를 4x4mm로 줄인 일본 모바일TV용 RF칩(RFG7200)이 공개되었다.



TDMB RFIC



TDMB RF + Baseband



ATSC M/H용 RFIC



CMMB, DVB T/H/C, ISDBT, TDMB 등 Multi standard RFIC



전시회 참여 기업 소개

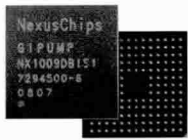
넥서스칩스



회사 소개

2001년에 설립된 팹리스 기업인 넥서스칩스(대표 김학근 www.nexuschips.com)는 모바일용 3D그래픽 가속칩 개발을 전문으로 하는 벤처기업이다. 넥서스칩스는 산자부, 정통부 주관의 '차세대 고성능 그래픽 GPU개발' 과제의 주관업체로 선정되어 프로젝트를 진행했으며 현재 삼성전자와 LG전자 등 모바일제조사 및 엑스로드와 같은 포터블업체에 가속칩을 공급하고 있다. 그래픽 가속칩은 모바일 환경에서도 고성능 그래픽을 사용하고 자 하는 어플리케이션(3D UI, 3D맵, 게임 등)을 사용할 수 있게끔 하는 솔루션이다. CPU만으로는 그 부하를 감당할 수 없으므로 성능을 만족시키지 못하고 PC의 구조로는 전력소모를 감당할 수 없기 때문에 모바일/임베디드 환경에 맞는 최적화된 그래픽 가속 솔루션이 필요한 데 이를 독자적인 기술로 국산화하여 세계 메이저 회사들과 경쟁을 하고 당당히 그 영역을 확대해 가고 있다. LG전자에 '페퍼민트 UI' 라는 브랜드를 붙인 버라이즌 향의 VX9700에 납품을 시작, 최단기간 100만대 판매돌파라는 기록을 세운 'Dare' 폰에 3D UI를 담당하고 있으며, 엑스로드의 3D내비게이션에 탑재, 3D맵을 가속하는 등 새로운 시장개척의 선두주자로 주목받고 있다. 사업영역으로는 GiPump™라는 브랜드의 그래픽 가속칩과 IP비즈니스, 그리고 시스템비즈니스를 진행 중이다.

전시제품 소개



포터블 관련제품의 예로서 RMI, 삼성, 마벨 등 각종 CPU와 LCD 사이에 위치하면서 3D UI 를 활용하는 3D 전자책자 등의 데모와 3D맵을 가속하는 엑스로드의 'Xroad 3D' 를 출시전에 최초로 전시

하여 데모를 보였다. 엑스로드의 3D내비게이션에 탑재되어 있는 제품은 'NX1007' 로서 초당 12백만 폴리곤을 처리하는 고성능제품이며 Video Input I/F를 Host I/F와는 별도로 두어 PIP 등을 hw적으로 지원한다. 미국 버라이즌에 LG전자에서 납품하고 있는 'Dare' 폰도 실물을 전시하였고 이 폰에는 'NX1009' 가 탑재가 되어있는데 초당8백만 폴리곤을 처리할 수 있으며 내부에 비디오 메모리를 스택하여 보다 빠른 처리가 가능하다.

칩스앤미디어



회사 소개

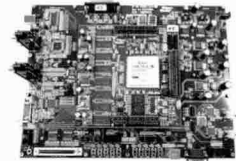
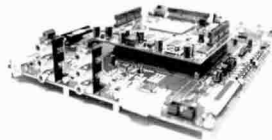
2003년에 설립된 Video IP 전문 개발 업체인 칩스앤미디어(대표 임준호 www.chipsnmedia.com)는 MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264/AVC, VC-1, RV 및 AVS 등 Video 표준에 대한 기술을 CIF급부터 Full HD급까지 모두 보유하고 있는 업체로서 2005년부터 Video 기술 Licensing을 시작해 국내는 물론 미국의 세계적인 반도체 회사인 Freescale을 비롯하여 중국, 대만, 유럽, 일본 등 세계 선두 반도체회사에 멀티미디어 IP를 공급하고 있다.

특히, 세계 최초로 H/W Realvideo HD decoder IP를 개발하였으며 새로운 중국 표준인 AVS decoder와 H.264 HD encoder 까지 개발을 완료하여 세계 선두 Video IP provider로서의 입지를 견고히 하였다.

전시제품 소개

칩스앤미디어가 새로이 선보이는 Coda75xx 및 Boda75xx series는 H.264 HP, H.263, MPEG-4 ASP, DivX, Xvid, MPEG-2, VC-1, RV8/9/10, AVS, MJPEG 등의 모든 video standard를 Full HD 해상도까지 지원하는 Video Codec / Decoder IP로써 Handset, PMP 등의 Mobile 기기에서부터 HDTV, Blu-ray, IPTV 등의 Consumer product까지 다양한 영역에서 Multimedia 기능을 수행한다.

H/W IP인 Coda, Boda series는 낮은 전력 소모와 Host CUP 에 resource를 1MIP 이하로 사용하는 구조로서 HD chip 제품에 보다 적합한 Video IP Solution으로서 활용할 수 있다.



전시회 참여 기업 소개

세미솔루션

Semi
Solution

회사 소개

세미솔루션(대표 이정원 www.semisoluton.com)은 국내의 제한적인 시스템 반도체 개발 환경을 극복하고자 해외 선도적 업체와 다양한 기술제휴를 통해 양질의 Engineering Service를 국내 Fabless System IC maker에 제공하고 있는 Total Fabless Engineering Service Company이다.

당사는 풍부한 경험을 갖춘 전문가로 구성된 Engineering Service Group을 통해 개발 초기의 FPGA 개발 지원은 물론 Design Service 및 최종 제품 개발 지원을 하고 있다. 또한 해외 선진 Design Service사와의 전략적 제휴를 통해 High-end SoC 제품의 Design 안정성과 질적 향상을 기하고 있으며, 특히 탁월한 성능의 SoC Platform을 이용한 Platform ASIC biz.는 팹리스 회사에게 새로운 개발 패러다임을 제공함으로써 그 우수성을 입증 받고 있다. 아울러 국내에서는 절대적으로 부족하여 확보하기 어려운 Special Analog IP 및 ESD Solution을 국내 팹리스 회사에게 지원함으로써 제품 조기 개발 및 Time to Market을 적극 지원하고 있다.

위와 같은 Total Engineering Service를 통해 최종적으로 당사의 Foundry Partner사와의 제휴로 국내 팹리스 고객의 제품 개발 및 양산까지 지원하고 있다. 이러한 당사의 One Stop Total Engineering Solution는 국내 팹리스 고객의 경쟁력 강화는 물론 시장의 독점적 지위를 확보하는데 크게 기여하고 있다.

전시제품 소개

• Foundry and Design Service

국내의 한정된 Wafer 가공 공정의 한계를 극복하기 위하여 해외 우수 Foundry사와 전략적 제휴를 통한 안정적인 파운드리 공급원을 확보하여 다양한 Process Solution을 고객에게 제공하고 있으며, 고객의 시장 경쟁력 확보를 위한 최적의 solution을 제공한다. 특히 Automotive/Industrial Spec. 용 Process 및 130nm/90nm 이상의 High-end SoC Process 지원에 역점을 두고 있다.

• ASIC and Full Customer Layout

RTL 및 Netlist Level로부터 Full Customer Layout에 이르기

까지 고객의 Needs에 맞는 다양한 Design Service를 제공하고 있으며, 또한 130nm 이상의 High-end SoC 제품의 Design 안정성 및 질적 향상을 위하여 세계 No.#1 Design Service회사인 대만 Faraday사와 국내 유일의 전략적 제휴를 통해 최고 품질의 ASIC 서비스를 제공하고 있다. 또한 각종 기업연구소 및 우수 대학과 연계하여 활발한 Design Co-work을 진행하고 있다.

• SoC Platform and FPGA solution

SoC Platform 및 FPGA solution은 고객의 제품 개발 기간 단축을 통한 Time to Market 실현 및 비용 절감의 효과를 극대화하고 있다. 특히 최근 도입한 Multimedia application향 H.264 SoC Platform은 고객의 기술력을 한층 더 Upgrade 하고 설계 완성도를 높이는데 크게 기여하여 큰 호응을 얻고 있다.

• Analog and Special IP solution

IC제품의 고집적화 및 SoC화에 따라 국내에서 기술력 확보가 어려운 Analog IP 및 Special IP를 세계 유수의 IP 전문회사와 전략적 제휴를 맺고 130nm이상의 High-end SoC 및 Special application향의 IP를 개발, 지원하고 있다.

• ESD solution

미국 ESD 전문 그룹인 GTL/API사와의 제휴를 통해 IC설계 시, 특히 SoC 제품에서의 효과적인 ESD Protection을 위한 Non-Snapback ESD IP 및 Design Consulting을 지원하고 있으며, 또한 System Level에서 보다 효과적이고 정확한 ESD 특성평가를 위한 Set Level ESD Solution을 제공하고 있다.



시스템반도체 컨퍼런스 2008

최고 권위의 시스템반도체 전문 컨퍼런스인 '시스템반도체 컨퍼런스 2008' 행사는 지난 10월 16일부터 17일까지 일산 KINTEX 중회의실에서 열렸다.

이번 행사에서는 통신, 가전, 자동차, 의료, 조선, 건설 등 주요 시스템 산업의 SoC시장과 기술을 총망라하는 강연이 펼쳐졌으며, 40여명의 국내외 대기업, 학계, 연구소의 최고 전문가들이 주제발표자로 나서 참가자들과 고급 정보를 나누었다.

특히, 쉐컴의 김제우 부사장이 "Toward 4G Wireless Technologies"를, 현대자동차의 양웅철 부사장이 "차량용반도체 기술동향"을 기조연설을 통해 강연하여 시스템업계와 반도체업계의 주요 이슈와 향후 전망에 대해 심도 있게 다루었다.

● 행사개요

- 행사명 : 시스템반도체 컨퍼런스 2008
- 일 시 : 2008년 10월 16일(목) ~ 17일(금) (2일간)
- 장 소 : KINTEX 2층 중회의실
- 주 최 : 지식경제부
- 주 관 : 한국반도체산업협회, 정보통신연구진흥원, 한국전자통신연구원

● 프로그램

날짜	시간	중회의실 210호	중회의실 211호	중회의실 212호
	10:00 ~ 10:30		등 록	
	10:30 ~ 11:10	Keynote Speech I : 4G Wireless Technologies (김제우 부사장, 쉐컴)		
	11:10 ~ 11:50	Keynote Speech II: 차량용 반도체 기술동향 (양웅철 부사장, 현대자동차)		
	11:50 ~ 12:05	시스템반도체 컨퍼런스 2008 개막식		
10/16 (목)		Session 1 (방송산업) 좌장 : 엄낙웅 부장, 한국전자통신연구원	Session 2 (자동차IT) 좌장 : 정희식 연구위원, 한국자동차산업연구소	Session 3 (건설IT) 좌장 : 최현상 실장, 한국건설기술연구원
	14:00 ~ 14:40	3DTV/UHDTV 기술 동향 (김진웅 책임연구원, ETRI)	텔레매틱스용 Voice User Interface 기술 동향과 전망 (권오일 박사, 현대오토넷)	유비쿼터스 시대의 건설산업 전망 (황찬규 교수, 서울벤처정보대학원)
	14:40 ~ 15:20	모바일 IPTV 기술 동향 (박수홍 책임연구원, 삼성전자)	자동차용 통신네트워크와 ITS (이상선 교수, 한양대학교)	도시시설물의 지능화 융합IT 기술 (송병훈 박사, KETI)

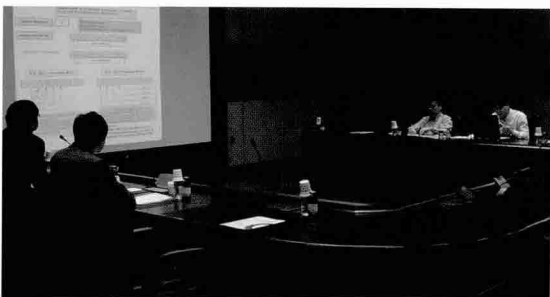
Coffee Break			
10/16 (목)	15:40 ~ 16:20	ATSC 디지털 TV 전송 방식 발전 : Mobile TV (곽국연 상무, LG전자)	차량용 HMI(Human Machine Interface) 기술동향 (손준우 박사, 대구경북과학기술연구원)
	16:20 ~ 17:00	DTV를 위한 원색재현 (조맹섭 책임연구원, ETRI)	자동차용 반도체 기술 개발 사례 (이승우 이사, 인피니언)
		등 록	
		Session 4 (통신산업) 좌장 : 정희범 부장, 한국전자통신연구원	Session 5 (의료IT) 좌장 : 장성호 기술역, 정보통신연구진흥원
	09:30 ~ 10:10	무선통신 기술발전 전망 (안재민 사업단장, IITA)	의료산업 현황 및 전망 (김영호 원장, 원주의료기기테크노밸리)
	10:10 ~ 10:50	이동통신 서비스 발전 방향 (이준철 부장, KTF)	초음파진단기 기술과 주요 ASIC (이현우 수석연구원, 메디슨)
		Coffee Break	
	11:10 ~ 11:50	차세대 Wireless PAN 칩셋 개발 (이우용 팀장, ETRI)	캡슐형 내시경 마이크로 시스템 (황인학 센터장, 전자부품연구원)
	11:50 ~ 12:30	LTE 통신시스템을 위한 SoC 개발방향 (최진성 상무, LG전자)	의료용 마이크로로봇 첨단기술 (박중오 교수, 전남대)
10/17 (금)		Session 7 (가전산업) 좌장 : 이윤식 박사, 전자부품연구원	Session 8 (산업분석 및 전망) 좌장 : 이민영 팀장, 한국반도체산업협회
	14:00 ~ 14:40	가전 네트워크/서비스 컨버전스기술 및 산업동향 (윤명현 센터장, KETI)	한국경제 2008년 결산 및 2009년 전망 (김경원 전무, 삼성경제연구소)
	14:40 ~ 15:20	정보가전기 산업/시장 동향 (손진호 책임연구원, LG전자)	시스템반도체 시장전망 (손중형 대표, iSuppli)
		Coffee Break	
	15:40 ~ 16:20	가전의 융합기술 및 시장 동향 (이광기 수석, 삼성전자)	시스템반도체 산업정책 (차동형 과장, 지식경제부 반도체디스플레이과)
	16:20 ~ 17:00	차세대 융합형 DTV서비스 (박선규 박사, KBS)	시스템반도체 사업전략 (이윤태 전무, 삼성전자)
		IT기반 교량 모니터링 기술 소개 (장정환 사장, TM E&C)	
		IT 기반의 시설물 모바일 점검시스템 (KMIS) (이정석 팀장, 한국시설안전기술공단)	
		Session 6 (조선IT) 좌장 : 임동선 팀장, 한국전자통신연구원	
		해양조선환경변화와 시스템반도체 활용 전망 (유영호 교수, 해양대)	
		조선산업 초일류화를 위한 IT기반 선박용 토달 솔루션 기술 (김재명 팀장, ETRI)	
		조선산업에서의 RFID /USN 기반 안전관리 응용 사례(조성우 부장, 현대중공업)	
		첨단 선박기자재 개발동향 (배정철 본부장, 한국조선기자재연구원)	
		Session 9 (국방IT) 좌장 : 이윤희 센터장, 국방과학연구소	
		미래 국방IT기술 동향 (김철호 부장, 국방과학연구소)	
		차세대 무인체계 통신 기술 발전 동향 (변승완 상무, 삼성탈레스)	
		감시정찰 센서네트워크 기술개발동향 (김영민 상무, LG넥스원)	
		전술 데이터링크 기술 (이창학 이사, 쌍용정보통신)	

LG Day

작년에 이어 올해로 2회를 맞은 LG Day가 10월 16일, 17일 양일간 KINTEX에서 개최되었다. 이 행사는 국내 대표 IT기업인 LG전자의 모바일커뮤니케이션사업본부가 참여하여 우수 시스템 반도체기업과 1:1 비즈니스미팅을 갖고 상호협력 방안을 모색하는 뜻 깊은 행사이다. 이번 LG Day에는 빅서스칩스, 엘디티, 포인칩스, 동운아나텍, 엠진, 펄서스테크놀로지, 씨엔엠마이크로, 엑스커뮤니케이션, 코아리버 등 13개 모바일 관련 시스템반도체 기업이 참가했다. LG Day에 참가했던 업체의 담당자는 “LG의 제품 로드맵에 대해 깊이 이해할 수 있었고, 당사 제품 개발에도 반영할 부분이 많았다. 이후에는 LG 뿐 아니라 삼성 Day도 개최하고, 또 모바일 분야에만 국한하지 않고 다양한 사업부와 미팅이 가능했으면 좋겠다.”고 말했다.



〈LG전자, 펄서스테크놀로지 Meeting〉



〈LG전자, 캄트로닉스 Meeting〉

● 행사개요

- 행사명 : LG Day
- 일 시 : 2008년 10월 16일(목)~17(금)
- 장 소 : KINTEX 3층 중회의실
- 주 최 : 지식경제부
- 주 관 : 한국반도체산업협회, 정보통신연구진흥원, 한국전자통신연구원

해외 바이어 초청 비즈니스 상담회

올해로 5회를 맞은 해외바이어 초청 1:1 비즈니스 상담회는 일본의 대표 IT기업인 Sharp와 KAKA Electronics 등 처음으로 참가하는 해외 대형업체가 그 어느 때보다도 많았다. 이는 국내 시스템반도체가 세계 시장에서 어깨를 나란히 할 수 있는 경쟁력을 확보했음을 의미하는 청신호다.

중국기업으로는 중흥통신, Malata, Huaqi, 청화동방, T3GT 등 중국 대표 IT업체에서 총경리 또는 연구, 구매 부서의 책임자들이 참석했으며, 델파이 중국사업본부, 소니에릭슨 중국 사업본부 등 세계적인 IT 기업들도 새로 합류했다.

이에 아이앤씨테크놀로지, 펄서스테크놀로지, 다들멀티미디어, 이시티, 이디텍, 넥실리온, 픽셀플러스, 엘디티, 코아리버, 렛스비전, 씨엔엠마이크로, 크로바하이텍, 캄트로닉스, 애트랩, 엑스커뮤니케이션, 이미지스테크놀로지 등 26개 디스플레이 및 모바일 솔루션, 모듈업체들이 한국 IT부품산업을 대표하여 대일본, 대중국 비즈니스에 나섰다.

비즈니스상담회에 참가한 한 업체 담당자는 “초청하는 바이어들이 더 다양해져서 좋다. 직접 찾아가서 만나기도 어려운데 협회에서 단체로 초청해 상담을 진행하니 시간과 비용이 절약됐을 뿐 아니라 바이어들의 상담 태도도 매우 진지해 모처럼 성과 있는 상담이 되었다.” 라며 큰 만족감을 표했다.



● 행사개요

- 행사명 : 해외 바이어 초청 비즈니스 상담회
- 일 시 : 2008년 10월 16일(목)~17(금)
- 장 소 : KINTEX 3층 그랜드볼룸
- 주 최 : 지식경제부
- 주 관 : 한국반도체산업협회, 정보통신연구진흥원, 한국전자통신연구원



비즈니스 상담회 바이어 명단

No.	회사명	영문이름	직 급	관 심 품 목	생 산 품 목
1	Sharp	Masayuki Miyamoto	Deputy General Manager	RF 등 휴대용모바일기기 부품	가전, 휴대용모바일기기 등
2	Kaga Hightech	Hiroo Ito	Technical Marketing Dept. Senior Manager	카메라, 셋톱박스, LED모듈 관련 부품	카메라, 셋톱박스, LED모듈, 전자제품 OEM전문업체
		Yoshitaka Sumie	Kansei Sales office, Assistant Manager		
3	ZTE	Feng/Tiegang	스마트폰/휴대폰부장	휴대전화부품 및 DMB 부품	휴대전화, 통신설비 등
		Ji/Zhongwei	스마트폰/휴대폰부 총공정사		
4	Huaqi	Zhi/Bin	Product Manager	MP3, PMP, DMB관련 부품	MP3, PMP, DMB 등
5	DELPHI(중국)	Zhu/Liyi	신제품개발부 경리	GPS, 차량용멀티미디어제품 부품	차량용 멀티미디어 제품 등
6	Malata	Fang/Weidong	차량용제품부 총경리	카 네비게이션 등 차량용 멀티미디어제품 부품	가전, 휴대전화 등
7	T3GT	Yang/Longbo	Product Manager	휴대전화부품	D-SCDMA 메인칩, 플랫폼
		Yuan/Xun	IC제품 경리		
8	청화동방	Dapeng Xiong	R&D 부총경리	MP3, PMP, DMB관련 부품	MP3, PMP, DMB 등
9	Sony Ericcson	Ye/Minhua	Product Manager	휴대전화부품 및 DMB부품	휴대전화
10	Innofidei	Ba/Shan	Senior Sales Manager	휴대기기부품 및 DMB부품	CMMB 메인칩, 플랫폼
11	Leaguerdtv	Wang/YongLing	R&D 부장	MP3, PMP, DMB관련 부품	MP3, PMP, DMB 등
		Zhu/YongLiang	R&D 총감		
12	Capitel	You/Donghui	Project Manager	휴대전화부품 및 DMB 부품	휴대전화
		Liu/Qiaoguang	휴대단말연구소장		
13	AnyDATA	Liu/Chunqin	CEO	휴대전화부품	디자인하우스
		Zhao/Lei	CTO		
14	Si Praha	S.W.Jung	Vice President	휴대전화부품	디자인하우스
		Jeff Cui	Product Manager		
15	Smartworks	Lin Song	President	휴대전화부품	디스트리뷰터

기술이전 Fair

올해 처음 열린 기술이전 Fair에서는 한국전자통신연구원, 전자부품연구원, 한국과학기술원 등 연구소와 대학에서 개발한 핵심기술들을 산업체가 이전 받아 기술경쟁력을 강화할 수 있는 자리를 마련하였다.



한국전자통신연구원은 차세대 지상파 DMB칩 기술 등 10개 기술, 전자부품연구원이 고속 직렬통신용 칩 기술 등 3개 기술, 한국과학기술원이 지상파 DMB칩 관련 SiP 기술 등 3개 기술을 산업체에 이전하기 위해 설명회를 가졌으며, LG전자, 코아로직, 다들멀티미디어 등 여러 산업체에서 참여하였다.



● 행사개요

- 행사명 : 기술이전 Fair
- 일 시 : 2008년 10월 14일(화) 14:00~17:00
- 장 소 : KINTEX 전시장 4홀
- 주 최 : 지식경제부
- 주 관 : 한국반도체산업협회, 정보통신연구진흥원, 한국전자통신연구원

● 발표 주제

	시 간	발 표 자	기 술 명
1	14:00~14:10	ETRI 구본태 팀장	Advanced T-DMB 수신 SoC
2	14:10~14:20	ETRI 구본태 팀장	저전력 임베디드 DSP core
3	14:20~14:30	ETRI 강성원 팀장	인체통신 SoC
4	14:30~14:40	ETRI 박성모 팀장	저전력 H.264 인코더 SoC
5	14:40~14:50	ETRI 문재경 박사	밀리미터파 대역 MMIC 스위치
6	14:50~15:00	ETRI 권오균 박사	2.5G R-SOA 칩
7	15:00~15:10	ETRI 송윤호 박사	국부 디밍 BLU용 탄소나노튜브-전계방출 램프
8	15:10~15:20	ETRI 황치선 박사	투명전자소자를 이용한 스마트 창
9	15:20~15:30	ETRI 박강호 팀장	u-단말용 나노융합센서
10	15:30~15:40	ETRI 양일섭 박사	u-단말용 Universal-Chip
	15:40~16:00		Coffee Break
11	16:00~16:10	KETI 이성철 책임	고속 I/O 용 3Gbps/Ch급 SERDES
12	16:10~16:20	KETI 이성철 책임	센서용 16비트 ADC
13	16:20~16:30	KETI 정용무 선임	UMO 자원공유기반 플랫폼
14	16:30~16:40	KAIST 이희재 팀장	T-DMB SiP Design to Improve RF Sensitivity
15	16:40~16:50	KAIST 이희재 팀장	UHF RFID Reader and Tag SiP Design for Mobile Application
16	16:50~17:00	KAIST 이희재 팀장	24GHz Radar Sensor SiP



Job Fair

한국전자통신연구원 시스템반도체산업진흥센터는 SoC Fair 2008 부대행사의 하나로 IT-SoC전공인증과정 학생 대상 "Job Fair"를 개최하였다. 한국전자통신연구원은 2004년부터 시스템반도체 설계 전공인증자 과정을 개설하여 지난 4년간 716명의 과정 이수자를 배출하였다. 또한 취업희망자 486명 가운데 463명이 취업하여 전체 취업률 95.3%, 중소기업 취업률 37.4%라는 높은 실적을 보였다.

올해 5회째를 맞이하는 Job Fair는 전국 63개 대학 1,300여명의 IT-SoC전공인증과정 석박사 학생, 특히 2009년 2월 졸업예정자 및 기 졸업자를 중심으로 면접을 진행한다. 엠텍비전, 티엘아이, 텔레칩스 등 7개의 우수 시스템반도체기업들이 참여하여 채용면담을 실시하였다.



● 행사개요

- 행사명 : Job Fair
- 일 시 : 2008년 10월 15일(수)~16일(목)
- 장 소 : KINTEX 전시장 4홀
- 주 최 : 지식경제부
- 주 관 : 한국전자통신연구원, 한국반도체산업협회, 정보통신연구진흥원

● 참석대상 기업

- IT-SoC 인력양성 후원기업(현재 22개) 중 참가신청서를 제출한 7개사

No.	참가기업
1	(주)넥스트칩
2	네오피델리티(주)
3	(주)씨앤에스테크놀로지
4	엠텍비전(주)
5	(주)파이칩스
6	(주)티엘아이
7	(주)텔레칩스

● 참여대상 학생

- 한국전자통신연구원이 설계교육을 통해 양성한 우수 엔지니어
- 한양대학교 등 14개 학교, 학생 29명